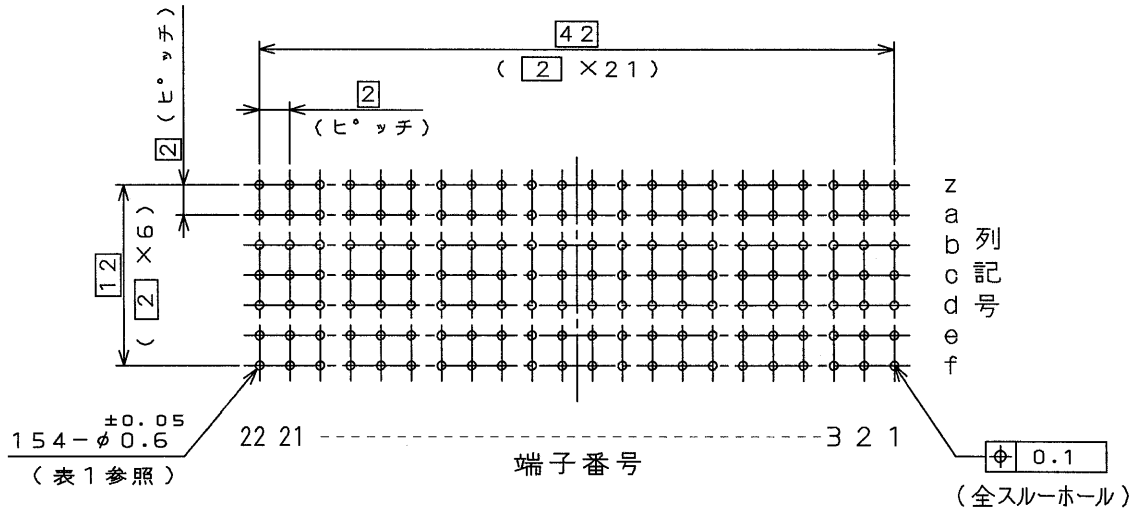


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	1999.8.4	43769	ロット番号位置変更及び注4追加,他	——	木村(雅)	柏木	水野
3	2000.2.22	45561	公差変更,他	——	木村(雅)	柏木	安井
4	2000.7.14	46473	表1変更	——	木村(雅)	柏木	安井
5	2003.5.16	51528	形状変更	桜田	木村(雅)	——	柏木

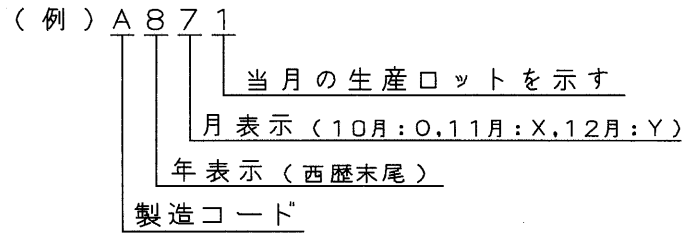
下穴ドリル径	φ0.7 ±0.025
仕上径 (銅スルーホールめっき)	φ0.6 ±0.05 (NOTE 4)
適合基板厚	t1.4 以上 (NOTE 4)
銅めっき厚	25 μm MIN
基板材質	カ*ラス布入り エポ*キシ積層板(標準)



命名法	MJ04-B110MSP-301G
シリーズ名	シリーズ名
ハウジングスタイル	ハウジングスタイル
基本芯数	基本芯数
開発コード	開発コード
接触部Auめっき厚	3: Au0.76 μm以上
結線部形状	P: フ*レスフィット, T: スルーホール
接続方向	S: ストレート, R: ライトアング*ル
コンタクトタイプ	M: ヒ*ン, F: ソケット

注1. コンタクトの使用本数, 寸法L1, L2及び仕上については、「コンタクト配列」を参照のこと。

△ 2. 図示の位置にロット番号を表示する。



3. 接触部のAuめっき厚は命名法を参照のこと。

△ 4. 銅スルーホールめっき上に半田めっきを行う場合は、半田めっき厚10 μm以下、基板厚t2.2以上とする。但し、銅スルーホールめっき後の仕上径はφ0.6 ±0.05 であり、半田めっき後の仕上径はφ0.55以上であること。

記号	使用コネクタ数	寸法: L1	寸法: L2	仕上 (注3)
N	66本	8.2 ±0.2	14.5 ±0.3	接触部(コンタクト両端) Ni(1.5 μm以上)上Auめっき
P	88本	9.7 ±0.2	14.5 ±0.3	フ*レスフィット部 Ni(1.5 μm以上)上Au(0.03 μm以上)めっき

2	インシュレータ	1	ガラス入りPBT	——	UL-94 V-0 ク*レイ
1	コンタクト	154 (注1)	銅合金	(注1)	——
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1584-*	第1版(ORIGINAL DATE) 1998.7.14	尺度(SCALE) 2	シリーズ(SERIES) MJ04	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号(DRAWING NO.) SJ033354
公差差(GENERAL TOLERANCE)	製造 DR.	担当 CHK.	木村(雅)	承認 APPD.	承認 APPD.
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	承認 APPD.	柏木	承認 APPD.	承認 APPD.
. ±0.8	X° ±				
.X ±0.4	X°X' ±				
.XX ±0.1					
.XXX ±					

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[MJ04-B110MSP-301G](#)